技 OSP24-008 2024 年 3 月吉日 株式会社 三桂製作所

樹脂製端子ボックス HJAP 附属部品袋の仕様変更のお知らせ

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社製品「樹脂製端子ボックス HJAP」の附属部品袋の仕様を変更致しますので 御案内申し上げます。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象品番

サンパーツ:樹脂製端子ボックス HJAP 各サイズ (附属部品袋 仕様変更)

2. 変更内容

HJAP 附属部品袋の仕様を下記のように変更致します。



3. 変更理由

お客様における利便性の向上、及び弊社における包装作業効率向上のための変更となります。

4. 変更時期

2024年5月1日出荷分より変更致します。

尚、出荷状況等により予定が変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。 出荷詳細、最新の情報については、お手数ですが各営業窓口までお問合せください。

仕様変更によりご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。